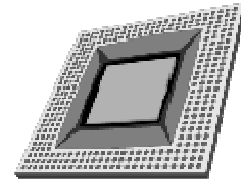


米 Artwork 社のソフトウェア・ツール

SFT では、Artwork 社のパッケージ設計用ツール・機械系・電気系 CAD に対応する各種変換ソフト・ビューア・プロットを中心とするツール・ユーティリティを販売いたしております。

■ パッケージ設計用ツール・ユーティリティ

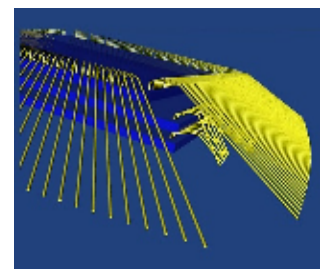
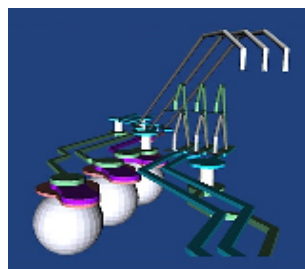
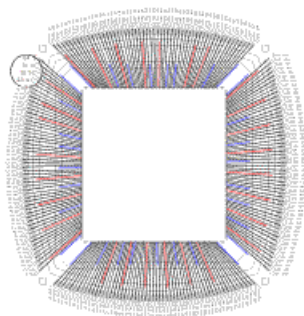
ArtWork 社では、業界標準のAIFファイルを中心に、パッケージ設計・チップデータの読み込み・配置・配線・DRC検証・三次元特性抽出等をサポートしています。AIFを介して、APD(Cadence 社)・PowerPCB・Zuken 等各社ツールとのインターフェイスが可能です。



APD-3D	パッケージの 3 次元モデル化 (Cadence の APD へのプラグイン) [New]
AIF2APD	APD 上の AIF のインポート・エクスポート (APD に標準組込済み)
ReadAIF	AIF の Virtuoso (Cadence) への読み込みツール
AIF Viewer	AIF のビューア (無料プログラム配布中) [Free]
Wirebond Tagger	AutoCAD 用ワイヤーボンディング図面の作成 (チップの読み込み・配置・配線・DRC)
Tagger V3	MCM/ Stacked Die 用のアプリケーション [New]
FlipChip Planner	大規模フリップチップの bumps 配線の設計ツール [New]
FA4ST	第 2 世代パッケージ設計ツール (PBGA/ SBGA/ TAPE/ HPBGA)
BondGen	高速ボンディング配線ツール
SmartDie	GDSII からの、チップの座標及びピンの抽出
WriteDie	Virtuoso からのパッドリング抽出 (SKILL)
Docgen	BGA 設計の仕様書の作成
BallMap	テキストファイルから BGA 端子 Excel ファイルを作成 (信号名/JEDEC) [New]

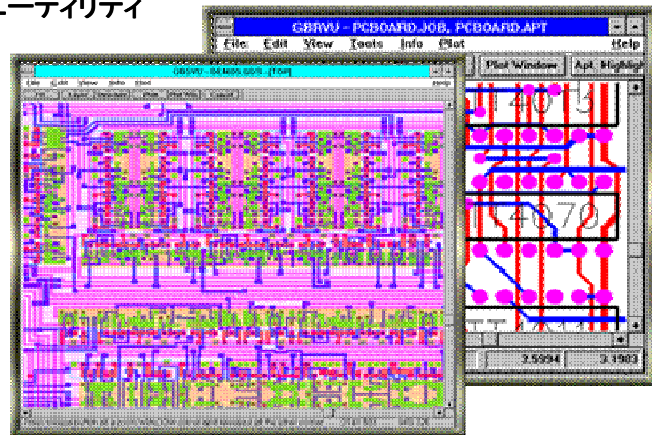
AIF: Text based data Exchange Format (Artwork / Cadence / Xynetix)

APD: Advance Package Designer (Cadence)



■ ビューア・プロット及び各種ツール・ユーティリティ

Artwork 社では、大規模な SoC のレイアウトデータを容易に扱うビューア・プロット等各種ツール及びユーティリティを取り揃えております。Artwork 社は、LSI 設計の領域のみならず、パッケージ開発・プリント板開発の領域までカバーします。



Garber	GBRVU	Garber (RS274D/RS274X/ MDA) ビューア&プロット(UNIX / Windows)
	GBRVU/X	GBRVU + GBR2DXF
	GBR_RIP UNIX	Gerber の高精度・高速 RIP (Solaris and HP/UX)
	GBR_RIP II	Gerber の高精度・高速 RIP (OEM: Windows NT II)
	NETEX-G	Gerber (drill /stackup) → PCB 用 3D モデル(SI 解析用) [New]
	GBRUnion	Gerber ファイルのフィルター
	GBRComp	Gerber ファイルの比較(XOR) [New]
DXF	eXtract	GDSII ビューア及び、部分データの DXF への変換
	BFLAT Pro	DXF の階層展開・フィルター
	BB Pro	AutoCAD 用バウンダリ・ビルダ
GDSII	QCKVU	高速・高性能 GDSII ビューア [Hot]
	for PROLITH	GDSII/MEBES => PROLITH マスクファイル(Windows) [New]
	for PROLNK	GDSII/MEBES の KLARF での欠陥解析 [New]
	GDS PLOT	GDSII プロット [Hot]
	QIS	QCKVU イメージサーバー
	GDSVU	GDSII ビューア&プロット(低価格)
	GDSTILE	GDSII の分割
	GDSFILT	GDSII から必要データを抽出
	QCKBOOL	GDSII のブール演算
	GDS-SR	GDSII ステップ・アンド・リピート(パンプ・MEMS・WSP) [New]
	NETEX	GDSII からのネット抽出(不良解析用)
MEBES	MBSVU	MEBES (versions I ~ V) 高速ビューア
CIF	CIFVU	CIF ビューア&プロット
MIC	MICVU	MIC ビューア&プロット
MI	MECHVU	MI ビューア&プロット(UNIX / Windows)

DXF: Drawing Interchange File (AutoCAD)
GDSII: Stream format for IC layout
MEBES: Electron Beam mask file
Allegro: Cadence tool
BoardStation; Mentor tool (PCB design)
HPGL: HP's plot file HPGL/HPGL2
MIC: Micronic Laser Writer

Garber: Format for PCB (RS274D/RS274X/ MDA etc.)
CIF: Caltech Intermediate Format for IC layout
MI: file format of HP ME-10 / Solid Designer
EGS: archive of Engineering Graphics System (HP)
IGES: Initial Graphics Exchange Specification
3D-STL: file format for Stereo-lithography
PG: PG data for Electromask and David Mann machines

■ Artwork 社について

Artwork Conversion Software, Inc. 1320 Mission St. Suite 5 Santa Cruz, CA 95060
Tel (408) 426-6163 Fax (408) 426-2824 email: info@artwork.com WEB: www.artwork.com

Artwork 社は、1987 年に Steve DiBartolomeo と Antonio Morawski によって設立され、1989 年に株式会社になりました。二人の創設者は電気工学の高級学位を持ち、Artwork 社を設立する前に RF、ハイブリッド、半導体設計において 10 年以上もの経験を持っています。

Artwork 社は、様々な機械設計ソフトウェアや電子設計ソフトウェアにデータ変換を可能にする CAD 変換プログラムを開発しています。Artwork 社は、またとても巨大な IC データベースをプロットする特別なソフトウェアも開発しています。最近、Artwork 社は IC パッケージ設計の分野に入り、ソフトウェアとサービスを提供しています。本社はカリフォルニア州サンタ・クルーズにあり、同州マンハッタン・ビーチには開発オフィスがあります。

カスタマ・ベース

5000 社以上もの企業を代表する 9000 人以上もの弊社ソフトウェアのユーザーを抱えております。その大多数は、AMD、Alcatel、Intel、Allied Signal、Motorola、ソニー、日立、Hewlett Packard、東芝、富士通、Samsung、Seagate、TRW、Bosch、Siemens、Ericsson、Nokia 等の電気製造業や半導体製造業の企業です。

製品評価をご希望のお客様は、下記までお申し付け下さい。1 ヶ月間、無料でお試し頂けます。

【お問い合わせ】

アートワーク・ソリューションズ合同会社
〒192-0361 東京都八王子市越野 11-13 Ⅲ-107
電話 042-675-6345 FAX 042-675-6345
担当 山本 健次 (090-2475-8790)
E-mail: yamamoto@artwork-solutions.co.jp